

第89回講演会レーザ加工学会 大阪大学 銀杏会館

1日目 2018年5月23日(水)

ホール					
10:00 開会の辞					
10:05 ポスターショートプレゼンテーション(各2分間、ホール) + ポスタープレゼンテーション					
昼食休憩(12:00~13:00)					
ホール					
プレナリーセッション		塚本雅裕 (大阪大学)			
13:00	【基調講演1】 レーザ加工のモニタリングと知的生産システム	小林 洋平 (東京大学)			
13:50	【基調講演2】 (仮) SIP革新的設計生産技術「次世代レーザコーティング」および「高輝度青色半導体レーザ開発」	塚本 雅裕 (大阪大学)			
総会 (14:40~15:10)					
Coffee break (15:10~15:20)					
ホール		大会議室			
23A1	レーザ加工の優位性—競合加工技術との比較	木谷 靖	23B1 短パルスレーザを駆使した細胞制御	細川陽一郎	
15:20	【特別講演】レーザ・電子ビーム・アークによる3D金属積層造形技術の比較	木寺 正晃 (愛知産業株)	15:20	【特別講演】短パルスレーザを応用した眼科医療機器開発	足立 宗之 (株ニデック)
16:00	溶断工場に用いられる各種切断機の性能と特長	山本 健太郎 (日酸TANAKA株)	16:00	短パルスレーザを駆使した細胞組織化・疾病メカニズムの解明	吉川 洋史 (埼玉大学)
16:30	レーザ溶接と電子ビーム溶接の比較	西原 啓三 (東成エレクトロビーム株)	16:30	超短パルスレーザを用いた機能性ポリマーの3次元バイオチップデバイス作製	花田 修賢 (弘前大学)
17:00	レーザ焼入れと高周波焼入れの比較	後藤 光宏 (富士高周波工業)	17:00	フェムト秒レーザ細胞制御による生体組織の治癒メカニズムの解明	松井 貴輝 (奈良先端科学技術大学院大学)
17:30	終了		17:30	終了	
懇親会 (17:45~19:30)		ポスター講演優秀賞発表			

2日目 2018年5月24日(木)

ホール		大会議室			
24A1	高効率・コンパクトレーザおよびモニタリング技術	門屋輝慶	24B1 ナノ・マイクロ加工、産業応用	渡邊 隆、岡本 康寛	
9:30	【特別講演】トルプの最新レーザ溶接システム	中村 強 (トルプ株)	9:30	超短パルスレーザによる金属加工プロセスの現象可視化	安田 浩一郎 (株デンソー)
10:10	ファイバレーザによる異種金属の接合	田村 悟 (住友重機械工業株)	10:00	Beamshaping of High Power Single Mode UV Lasers	Matthew Currie (Power Photonic)
10:40	最新ファイバレーザ及び周辺機器とその応用	水谷 重人 (コヒレント・ジャパン株)	10:30	レーザによる繊維への微細マーキングと眼鏡レンズ染色	植田 浩安 (静岡県工業技術研究所)
11:10	(仮) Seam Tracking with Remote Laser Welding Head RLSK	Matthias Kuehnel (II-VI)	11:00	Ni基超合金のレーザ肉盛	山口 拓人 (大阪産業技術研究所)
昼食休憩 (11:40~12:40)		昼食休憩 (11:30~12:30)			
ホール		大会議室			
24A2	レーザ加工応用・適用事例	山崎洋輔	24B2 ピーニング	佐野智一	
12:40	100 kWファイバレーザによるビード整形工法	住森 大地 (株ナ・テックスプロダクツ)	12:30	【特別講演】レーザピーニングのこれまでとこれから	佐野 雄二 (科学技術振興機構)
13:10	超伝導トカマク装置JT-60SAにおける真空容器内機器保守に向けたレーザ溶接ツールの開発	林 孝夫 (量子科学技術研究開発機構)	13:10	携帯型装置の開発に向けたレーザピーニングの低出力化の検討	崎野 良比呂 (近畿大学)
13:40	レーザラッドバルブシート開発	谷中 耕平 (トヨタ自動車株)	13:40	ショットピーニングとレーザピーニングの効果の違いとそのアプリケーション	澁谷 紀仁、小林 祐次 (新東工業株)
14:10	レーザ積層造形法により作製した析出型Cu-Cr合金の特性	内田 壮平 (大阪産業技術研究所)	14:10	新しいレーザピーニング技術：犠牲層を用いない大気中で施工可能なドライレーザピーニング	佐野 智一 (大阪大学)
14:40	フォトリソグラフィ構造ファイバによるハイパワー伝送技術	藤谷 泰之 (三菱重工業株)			
Coffee break (15:10~15:30)		Coffee break (14:40~15:00)			
ホール		大会議室			
24A3	レーザ加工現象解析・シミュレーション	尾崎仁志	24B3 パターニング技術	溝尻瑞枝、田中健一郎	
15:30	レーザ切断加工におけるダイナミック現象—熱源スポットの形成と切断への関与—	新井 武二 (中央大学)	15:00	【特別講演】レーザ照射とグリオキシル酸銅錯体を用いた大気中での銅パターニング	大石 知司 (芝浦工業大学)
16:00	【特別講演】計算科学シミュレーションコード SPLICE によるレーザ溶融・凝固プロセスの評価	村松 壽晴 (日本原子力研究開発機構)	15:40	【特別講演】レーザ転写技術を用いた強誘電体薄膜の圧電基板への集積化	平野 栄樹 (東北大学)
16:40	(仮) SLM過程におけるレーザ照射部周りの温度分布と溶融池形状の予測	池庄司 敏孝 (近畿大学)	16:20	(仮) 非接触高粘度銀塩インクのレーザ転写	荒木 徹平 (大阪大学)
			16:50	レーザ彫刻印刷版によるプリンテッドエレクトロニクスへの展開	西山 聡 (株プリントプロ)
17:10	終了		17:20	終了	